

LITERATURVERZEICHNIS

In diesem Verzeichnis wird sowohl die von den Autoren dieses Leitfadens als auch andere in den letzten Jahren veröffentlichte relevante, teilweise auch über die **Thematik des Vergießen von elektronischen Baugruppen** hinausführende Literatur aufgeführt. Bei der aufgelisteten Literatur wird allerdings kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

| | |
|----------|--|
| [Ala09] | R. Alarcon, „Umweltfreundliche Reinigung: Wasserbasierender Reinigungsprozess ersetzt HFCKM“, SMT, 22 (2009) Heft 08/09 S.14-15. |
| [Aßf04] | C. Aßfalg, „Reinigung und Bleifrei: Neuester Stand“, Productronic, Heft 5-6 (2004) 22-24. |
| [Asy06] | Seminar-CD zu Asymtek-Technology Days Juni 2006 mit Beiträgen von E. Vanlathem (Dow Corning), I. Sheiham (Beck), J. Mycke (Asymtek), M. Kaing (HumiSeal), S. Schröder (Peters), A. Hilton (Emerson & Cuming), I. Wilding, (Henkel), K.-F. Becker (IZM) und R. Tijburg (Philips). |
| [Bag88] | E. Bagda, „Zum Feuchtehaushalt von Beschichtungen“, farbe + lack 94 (1988) 8, 606-609. |
| [Ben06] | „Eigenschaftsbilder neuartiger Vergussmassen auf der Basis von Polyurethanen“, Seminarunterlagen OTTI-Fachforum „Vergießen in der Elektrotechnik und Elektronik“, 6./7. November 2006; OTTI-Kolleg. |
| [Ben07] | „Selection Criteria for Polyurethane Encapsulants in Electric and Electronic Applications“ Tagungsband <i>Inductica</i> , Berlin, Mai 2007. |
| [Ben08] | „Properties of Polyurethane Potting Resins based on Chemical Composition“, Tagungsband <i>Inductica</i> , Chicago, Oktober 2008. |
| [Ben09] | „Polyurethane Encapsulants in Electric and Electronic Applications requiring Flame-retardancy“, Tagungsband <i>Inductica</i> , Berlin, Mai 2009. |
| [Ben10] | „Industrial use of Polyurethane Encapsulants in Coil Winding Applications“, Tagungsband <i>Inductica</i> , Berlin, June 2010. |
| [Bou10] | S. Boudier, „Mikroemulsion auf Wasser-Basis – Alternativen zu hohen Lösemittelbelastungen“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 01/02 (2010) S. 24-25. |
| [Bri08a] | J. Bridges, „Weg in die „grüne“ Zukunft – Eine neue Ära im Schutzlackbereich“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03/04 (2008) S. 26-27. |
| [Bri08b] | J. Bridges, A. Stuart „Verlässlichkeit hoch, Kosten niedrig – Die Reinigung von Elektronik-Baugruppen ist unverzichtbar“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 07/08 (2008) S. 30-32. |
| [Bri11a] | J. Bridges, A. Stuart „Umweltschonend und flexibel – Entwicklungen und Trends in der Reinigungstechnologie“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03/04 (2011) S. 32-33. |
| [Bri11b] | J. Bridges „Schutzlack oder Vergussmasse - Wahl der Methode der jeweiligen Anwendung entsprechend“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 05/06 (2011) S. 26-27. |
| [Bün04] | K. Bünning, „Aspekte zur Erhöhung der Temperaturwechselbeständigkeit von Leiterplatten“, PLUS, 10, (2004). |
| [Col09] | S. Colier „6 Schlüsselemente zum Erfolg – System-Kartuschen und Zubehör für das Dosieren von Flüssigmedien“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 09 (2009) S. 43-44. |
| [Ehr99] | G.W. Ehrenstein, „Polymer-Werkstoffe“, Hanser-Verlag, (1999). |
| [Ell89] | B.N. Ellis, „Reinigen in der Elektronik“, Eugen G. Leuze Verlag, Bad Saulgau, (1989). |
| [Epp08a] | „Der Trend geht zur maschinellen Reinigung – Workshop zur Reinigung in der Elektronikfertigung“, EPP, Heft 07/08 (2008) S. 6-8. |
| [Epp09a] | „Qualität und Zuverlässigkeit als Maßstab des Lohnreingers – Nicht nur Hochzuverlässigkeits-Baugruppen müssen gereinigt werden“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 05/06 (2009) S. 19. |
| [Epp09b] | „Hoch automatisiert: Flexibler Umgang mit Typenvielfalt“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 10 (2009) S. 37-38. |
| [Epp10a] | „Reinigung optimiert Qualität und Kosten“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 01/02 (2010) S. 18-19. |

| | |
|---------------------|--|
| [Epp10b] | „Prozess flexibel, Durchsatz hoch – Elektronikdienstleister erweitert seine Reinigungskapazitäten“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 09 (2010) S. 46-47. |
| [Epp10c] | „Ruckzuck fixiert – Universeller Werkstückträger für den Lackier- und Trocknungsprozess“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 11 (2010) S. 30-31. |
| [Epp10d] | „Schutz von Komponenten – Optimierte Qualität der Hotmelt-Prozesse durch Extrudertechnik“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 11 (2010) S. 40. |
| [Epp11a] | „Wie clean ist No-Clean wirklich? – Workshop zur Reinigung in der Elektronikfertigung“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03/04 (2011) S. 34-37. |
| [Epp11b] | „Hightech-Automatisierung – Grenzen der automatisierten Produktion durch Vergusslösungen“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03/04 (2011) S. 65. |
| [EriXX] | S. Erickson „Präzise Beschichtungstechniken für Conformal Coating Anwendungen“ unter www.gps-technologies.com bzw. „Precision coating deposition techniques for conformal coating applications“ unter www.ultraspray.com |
| [Fla10] | T. Fladung, „Korrosionsschutz elektronischer Baugruppen durch Schutzlackierungen“, EBL 2010, 5. DVS/GMM-Tagung, 24./25. Februar 2010, Fellbach, Tagungsband S. 182-187. (DVS-Berichte Band 265; ISBN 978-3-87155-277-9) |
| [For08] | T.M. Forsythe, „Neue Methoden im Einzug – Bestimmung der Rückstandsfreiheit von Baugruppen mit geringen Boardabstand“, EPP, Heft 05/06 (2008) S. 62-65. |
| [Fra06] | J. Frank, „Auswahlkriterien für polyurethanbasierte Gießharzsysteme“, Seminarunterlagen OTTI-Fachforum „Vergießen in der Elektrotechnik und Elektronik“, 25./26. Januar 2006; OTTI-Kolleg. |
| [Fre99] | J. Freund, J. Halbritter, J.K.H. Körber, „How dry are Dried Samples? Water Adsorption Measured by STM“, Microscopy Research and Technique 44 (1999) 327-338. |
| [Fun89] | W. Funke, E. Fischer, „Haftfestigkeit organischer Beschichtungen auf Metallen bei Einwirkung von Wasser“, farbe + lack 95 (1989) 6, S. 403-407. |
| [GfK10] | Tagungsband GfKORR-Jahrestagung 2010 „Beschichtungssysteme zum Schutz elektronischer Baugruppen“, 09./10. November 2010, Frankfurt./M, ISBN 978-3-935406-43-7 |
| [Haa11] | J. Haase, E.-C. Reiff, „Optisch, berührungslos und leicht zu integrieren – Robuste Sensoren zur Profil- und Schichtdickenmessung“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 05/06 (2011) S. 51-53. |
| [Hab97] | G. Habenicht, „Kleben“, Springer-Verlag, (1997). |
| [HdT07]; [HdT10] | Tagungsunterlagen Fachveranstaltung „Vergusstechnik für die Elektrotechnik und Elektronik“, 22. März 2007 und 03. März 2010; Haus der Technik, Essen. |
| [Jil03] | W. Jillek, G. Keller, „Handbuch der Leiterplattentechnik“, Band 4, Eugen G. Leuze Verlag, Bad Saulgau, (2003). |
| [Kai92] | W.-D. Kaiser, S. Pietsch, A. Rudolf, „Zusammenhänge zwischen Permeations- und Adhäsionsverhalten sowie der Unterrostung organischer Beschichtungen“, farbe + lack 98 (1992) 3, 182-187. |
| [KamXX] | M.R. Kamal, R. Saxon, „Recent developments in the analysis and prediction of the weatherability of plastics“, Applied Polymer Symposia, 4:1-2, 19678. |
| [Kli01] | W. Klingel, „Die Zukunft der Schutzbeschichtung“, Productronic, Heft 03 (2001). |
| [Kli05a] | W. Klingel, „Vergusstechniken für den Schutz von Flachbaugruppen“, PLUS, Heft 5, (2005) 893-901. |
| [Kli05c] | J.-H. Klingel, „Nässe, Säure, Schmutz & Co. – Sichre Funktion durch Verguss“, Productronic, Heft 5-6 (2005) S. 30-31. |
| [Kli06a] | J.-H. Klingel, „Klimaausfälle sind vermeidbar“, Productronic, Heft 05 (2006) S. 64-65. |
| [Kli09a] | J.-H. Klingel, „Allroundtalent – Schutzbeschichtungsanlagen für elektronische Baugruppen“, Productronic, Heft 08/09 (2009) S. 23-25. |
| [Kli09b] | J.-H. Klingel, „Update für Lackieranlagen – Schutzbeschichtung bestückter Baugruppen“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 11 (2009) S. 47-49. |
| [Knö03] | P.A. Knödel, „Partielle Beschichtung nichttauchfähiger Baugruppen“, Productronic, Heft 11 (2003). |
| [Kol09] | P. Koller, „Baugruppenreinigung als Dienstleistung - Warum muss im Zeitalter von NoClean-Flussmitteln gereinigt werden?“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 07/08 (2009) S. 22-23. |

| | |
|---|--|
| [Kon09] | M. Konrad, „Vordefinierter Reinheitsgrad für Fluxentfernung in High-Yield-Anwendungen“, SMT, 22 (2009) Heft 08/09 S.12-13. |
| [Kuc11] | T. Kucharek, „Kostenfaktoren im Reinigungsprozess – Anschaffung und Betrieb von Reinigungsanlagen – Teil 1“, Productronic, Heft 03 (2011) 22-24. |
| [Län07] | M. Läntzsch, „Wie gefährlich sind Flussmittelrückstände? – Normen, Vorschriften, Grundlagen“, Seminarunterlagen zum OTTI-Fachforum „Schutzmaßnahmen zur Klimasicherheit elektronischer Baugruppen“, März 2007, Regensburg. |
| [Lie01] | J. Lienemann, „Testverfahren, Qualifikation und EMV“, IMTEK, Lehrstuhl für Simulation, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, (2001). |
| [Löw08] | R. Löw, J. Wilde, „Untersuchung zur Auswirkung von Feuchte auf elektrisch leitfähige Klebverbindungen“, GMM-Fachbericht Band 55 (ISBN 978-3-8007-3074-2) „Elektronische Baugruppen und Leiterplatten EBL 2008“, 4. DVS/GMM-Fachtagung, 13./14.02.2008, Fellbach, S. 213-218. |
| [Luc73] | W.A.P. Luck, „Structure of Water and Aqueous Solutions“, Verlag Chemie, Weinheim (1973). |
| [Man07] | O. Manger, H. Schweigart, „Wie sauber muss es sein? – Normen für die Reinigung von elektronischen Baugruppen“, Productronic, Heft 07 (2007) S. 18-21. |
| [Man11] | O. Manger, „Höchster Reinheitsgrad – Flexible Baugruppenreinigung für die Luft- und Raumfahrtindustrie“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 01/02 (2011) S. 25-26. |
| [Mar08] | B. March, A. Steinke, C. Matzner, C. Schimpf, „Ausfallverhalten elektronischer Baugruppen unter Betauungseinfluss“, GMM-Fachbericht Band 55 (ISBN 978-3-8007-3074-2) „Elektronische Baugruppen und Leiterplatten EBL 2008“, 4. DVS/GMM-Fachtagung, 13./14.02.2008, Fellbach, S. 201-206. |
| [Mue07] | M. Müller, „Verarbeitung von Gießharzen auf Basis von Polyurethan - Verarbeitungsfehler und deren Vermeidung“, Seminarunterlagen der Fachveranstaltung „Vergusstechnik für die Elektrotechnik und Elektronik“ im Haus der Technik, Essen, 22. März 2007. |
| [Neh05] | F. Nehmeier, „Feuchtigkeit und Schutzlackierung in der Kfz-Elektronik“, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 09. Juni 2005, Berlin, Tagungsband. |
| [Nev04] | B. Neves, „Accelerating PTH Reliability Testing while reducing Cost“, EIPC-Summer Conference 2004, Basel. |
| [Nol68] | W. Noll, „Chemistry and Technology of Silicones“, Academic Press (1968). |
| [Ott05a]; [Ott06a]; [Ott07a]; [Ott09a]; [Ott10a]; [Ott11a] | Tagungsband (CD) OTTI-Profiforum „Vergießen in der Elektrotechnik und Elektronik“, 16./17. März 2005; 06./07. November 2006; 20./21. Juni 2007; 28./29. April 2009; 16./17. Juni 2010; 07./08. Juni 2011; OTTI-Kolleg. |
| [Ott06b] | Tagungsunterlagen (CD) OTTI-Fachforum „Produktion bleifreier elektronischer Baugruppen“, 05./06. April 2006; OTTI-Kolleg. |
| [Ott07c]; [Ott08c]; [Ott09c]; [Ott10c]; [Ott11c] | Tagungsunterlagen (CD) OTTI-Fachforum „Schutzmaßnahmen zur Klimasicherheit elektronischer Baugruppen – Grundlagen, Technologien, Projektbeispiele“, 14./15. März 2007; 02./03. April 2008; 01./02. April 2009; 24./25. März 2010; 30./31. März 2011; OTTI-Kolleg |
| [Pap06] | U. Pape, M. Rittner, T. Liebl, N. Neher, M. Nowotnick, „Untersuchung der Zuverlässigkeit hochtemperaturgeeigneter Baugruppen“, GMM-DVS-Tagung, Fellbach, (2006). |
| [Pie92] | M. Piepho, „Sicherheitsaspekte bei der Gießharzverarbeitung“, Elektrizitätswirtschaft, 91 (1992) 1760. |
| [Pie94] | M. Piepho, „Vergleich der Eigenschaften unterschiedlicher Kaltverguss-Systeme für elektrische Anwendungen (Energiebilanzen synthetischer und teilsynthetischer Vergussmassen)“, Elektrizitätswirtschaft, 93 (1994) 1682. |
| [Pie95] | M. Piepho, „Vergleich von Vergussmassen“, ETZ, 116, Heft 23-24 (1995) 22. |
| [Pie97] | M. Piepho, „Füllstoffe in Elektroisolierstoffen“, ETZ, 118, Heft 6 (1997) 56. |
| [Pie01] | M. Piepho, „Unverzichtbar - Vergussmassen für Elektrotechnik und Elektronik“, ETZ, Heft 16 (2001) 26-29. |
| [Pie03] | M. Piepho, „Unverzichtbar: Vergussmassen für Elektrotechnik und Elektronik“, PU-Magazin, Heft 4 (2003). |

| | |
|----------------------|--|
| [Pie06a] | M. Müller, O. Bartels, M. Piepho, „ <i>Verarbeitung von Gießharzen auf Basis von Polyurethanen</i> “, etz, Heft 7 (2006) 44-47. |
| [Pie06b] | M. Müller, O. Bartels, M. Piepho, „ <i>Verarbeitung von Gießharzen auf Basis von Polyurethanen</i> “, PU-Magazin, Heft Juni/Juli (2006) 125-130. |
| [Pie07a] [Pie10a] | M. Piepho, „ <i>Vergussmassen, PUR, Epoxid, Silikon, Kohlenwasserstoffharze</i> “, Seminarunterlagen der Fachveranstaltung „ <i>Vergusstechnik für die Elektrotechnik und Elektronik</i> “ im Haus der Technik, Essen, 22. März 2007 bzw. 03. März 2010. |
| [Pol85] | <i>Polymer Permeability</i> , J. Comyn (ed.), Elsevier Applied Science, London (1985). |
| [Pol10] | G. Pollmann, „ <i>Klimaschock in der Steuerung kann fatale Auswirkungen haben – Schutz von Baugruppen beginnt bei der Reinigungstechnik</i> “, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03/04 (2010) S. 24-25. |
| [Plu82] | E.P. Plueddeman, „ <i>Silicone coupling agents</i> “, Plenum Press, New York, (1982). |
| [Plu10a] | „ <i>Sauberkeit ist mehr als eine Zier – Reinigen in der Elektronikfertigung</i> “, PLUS, Heft 01 (2010) S. 113-118. |
| [Plu10b] | „ <i>Substrate für die Leistungselektronik – Materialien, Eigenschaften, Techniken, Zuverlässigkeit</i> “, PLUS, Heft 09 (2010) S. 1834-1843. |
| [Plu10c] | „ <i>Reinigungsstrategien für die Elektronikfertigung – Kostenoptimiert zu bedarfsgerechter Sauberkeit</i> “, PLUS, Heft 10 (2010) S. 2086-2089. |
| [Rie08] | J. Riess-Frohberg, A. Harein, „ <i>Neue Reinigungskonzepte helfen – Kostensparende Fehldruckreinigung</i> “, EPP, Heft 02/03 (2008) S. 34-35. |
| [Rin09] | K. Ring, „ <i>Prüfmethoden zur Beurteilung von Schutzmaßnahmen an elektronischen Baugruppen</i> “, PLUS, Mai (2009) S. 1122-1125. |
| [Roc87] | E.G. Rochow, „ <i>Silicon and Silicones</i> “, Springer-Verlag, Heidelberg, (1987). |
| [Ros10] | G. Schulze, A. Rost, „ <i>Ressourceneffiziente Lackierung von Baugruppen</i> “, EBL 2010, 5. DVS/GMM-Tagung, 24./25. Februar 2010, Fellbach, Tagungsband S. 188-192. |
| [Ros11] | A. Rost, „ <i>Halogenfreie Lotpasten – ihr Einfluss auf die Baugruppenreinigung</i> “, SMT, 24 (2011), Heft 03, S. 22-26. |
| [Sche07] | W. Scheible, „ <i>Rechtliche Aspekte bei der Schutzbeschichtung elektronischer Baugruppen - Haftung</i> “, GfKORR-Seminar „ <i>Beschichtung elektronischer Baugruppen</i> “, 21. Juni 2007, Berlin, Tagungsband. |
| [Schm96] | K.G. Schmitt-Thomas, S. Wege, H. Schweigart, „ <i>Klimabedingte Ausfälle elektronischer Baugruppen: Prüfbarkeit und Schutzstrategien</i> “, 25. Jahrestagung der Gesellschaft für Umweltsimulation e.V., Pfinztal (1996) - Tagungsband, Karlsruhe: DWS Werbeagentur und Verlag, (1996), S. 14-1 bis 14-15. |
| [Schm97] | K.G. Schmitt-Thomas, S. Wege, H. Schweigart, „ <i>Wirksamkeit von Elektronik-Schutzlacksystemen gegen elektrochemische Migration und Kriechstrombrücken</i> “, in: Thomann (Hrsg.): <i>Werkstoffe für die Informationstechnik</i> . Frankfurt: DGM-Informationsgesellschaft, (1997) 151-155. |
| [Schu99] | G. Schulze, „ <i>Selektive und automatische Schutzbeschichtung von elektronischen Baugruppen</i> “, Productronic, Heft 07/08 (1999). |
| [Schu00] | G. Schulze, „ <i>Überragende Prozesskontrolle durch geschlossene Regelkreise</i> “, LP infos, Heft 11 (2000). |
| [Schu01a] | G. Schulze, „ <i>Berührungsloses Jet Dispensen in der Praxis</i> “, Productronic, Heft 03 (2001). |
| [Schu01b] | G. Schulze, „ <i>Automatische, selektive Beschichtung mit Dickschichtlacken</i> “, LP infos, Heft 04 (2001). |
| [Schu02a] | G. Schulze, „ <i>Automatische und selektive Schutzlackierung von bestückten Leiterplatten ohne zusätzliche Maskierarbeiten</i> “, GfKORR Tagung „ <i>Beschichtung elektronischer Baugruppen</i> “ Februar 2002, Frankfurt/M., Tagungsband. |
| [Schu02b] | G. Schulze, M. Reighard, „ <i>Automatisch Schutzbeschichten</i> “, Teil 1: Productronic Heft 05 (2002) 28; Teil 2: Productronic Heft 06 (2002) 48; Teil 3: Productronic Heft 07/08 (2002) 24. |
| [Schu03] | G. Schulze, „ <i>Automatische und selektive Schutzlackierung von bestückten Leiterplatten ohne zusätzliche Maskierarbeiten</i> “, GfKORR Tagung „ <i>Beschichtung elektronischer Baugruppen</i> “ März 2003, Berlin, Tagungsband. |

| | |
|-----------|---|
| [Schu04] | G. Schulze, „Aktuelle Technologien für die automatische und selektive Beschichtung von bestückten Flachbaugruppen“, in: DVS/GMM (Hrsg.), GMM-Fachbericht, Band 44 „Elektronische Baugruppen“, Vorträge der DVS/GMM-Fachtagung 04./05. Februar 2004 in Fellbach; S. 303-308. |
| [Schu05a] | G. Schulze, „Prozessregelung bei automatisierten und selektiven Beschichtungsverfahren“, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 09. Juni 2005, Berlin, Tagungsband. |
| [Schu05b] | G. Schulze, „Mehr Zuverlässigkeit durch Schutzlackierung“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03/04 (2005). |
| [Schu05c] | G. Schulze, „Kontaktloses Dispensjet Verfahren“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 09 (2005). |
| [Schu05d] | G. Schulze, „Prozessregelung bei automatischen Beschichtungsverfahren“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 11 (2005). |
| [Schu06] | G. Schulze, „Beschichtung mit Prozessregelung“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 07/08 (2006). |
| [Schu07a] | G. Schulze, „Performance im Detail“, Productronic, Heft 01-02 (2007) 21-22. |
| [Schu07b] | G. Schulze, „Automatische Dosierung und Beschichtung“, Seminarunterlagen der Fachveranstaltung „Vergusstechnik für die Elektrotechnik und Elektronik“ im Haus der Technik, Essen, 22. März 2007. |
| [Schu07d] | G. Schulze, „Innovative Dosiervverfahren mit integrierter Regelung“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 07/08 (2007) S. 36-38. |
| [Schu07e] | G. Schulze, „Emissionsfreie Produktion“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 09 (2007) S. 22. |
| [Schu07f] | G. Schulze, „Coating und Dispensing Plattform neu definiert“, Productronic, Heft 12 (2007) S. 28-31. |
| [Schu07g] | G. Schulze, „Die Spectrum Plattform – Beschichtung und Dosierung in neuer Dimension“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 12 (2007) S. 30-31. |
| [Schu08a] | G. Schulze, „Pulsweitenmoduliertes Beschichtungsventil für die selektive Schutzbeschichtung und den Verguss von bestückten Flachbaugruppen“, GMM-Fachbericht Band 55 (ISBN 978-3-8007-3074-2) „Elektronische Baugruppen und Leiterplatten EBL 2008“, 4. DVS/GMM-Fachtagung, 13./14.02.2008, Fellbach, S. 329-334. |
| [Schu09a] | „Punktgenau und reproduzierbar – Selektive Schutzbeschichtung in neuer Dimension“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 01/02 (2009) S. 29-30. |
| [Schu09b] | „Innovative Lösungen im Dispensbereich“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03/04 (2009) S. 62-63. |
| [Schu09c] | „Kleben und Beschichten in der Elektronikfertigung“, Adhäsion, April (2009) S. 14-17. |
| [Schu09d] | „Neue Technologien“, PLUS, Mai (2009) S. 1131-1137. |
| [Schu10a] | G. Schulze, „Zuverlässiges Coating – Automatische optische Inspektion von Schutzbeschichtungen“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03/04 (2010) S. 34-35. |
| [Schu10b] | G. Schulze, A. Rost, „Ressourceneffiziente Lackierung von Baugruppen“, EBL 2010, 5. DVS/GMM-Tagung, 24./25. Februar 2010, Fellbach, Tagungsband S. 188-192. (DVS-Berichte Band 265; ISBN 978-3-87155-277-9) |
| [Schw97a] | H. Schweigart, „Funktionssicherheit schutzlackierter elektronischer Baugruppen bei Feuchtklimabeanspruchung“, München, Hieronymus-Verlag, 1. Auflage (1997), 2. Auflage (1998). |
| [Schw97b] | H. Schweigart, S. Wege, „Prüfung von Lötstoppsmasken und Schutzlacken mittels thermischer Analyse“ (SMT ES&S Hybrid, Nürnberg 1997) - Tagungsband, Berlin: VDE-Verlag, 1997, S. 175-183. |
| [Schw98] | H. Schweigart, „Einfluss der Umgebungsbedingungen auf die Schutzwirkung von Elektronikschutzlacken“, 27. Jahrestagung der Gesellschaft für Umweltsimulation e.V., Pfinztal, (1998), Tagungsband. |
| [Schw99a] | H. Schweigart, „Ausfälle im Feld: teuer und vermeidbar?“, Productronic, Heft 10 (1999). |
| [Schw99b] | H. Schweigart, „Die Schaden- und Schwachstellenanalyse als Instrument des Testtailoring für die Klimasicherheit elektronischer Baugruppen“, 28. Jahrestagung der Gesellschaft für Umweltsimulation e.V., Pfinztal, (1999) Tagungsband. |

| | |
|-----------|---|
| [Schw00] | H. Schweigart, E. Christian, „Plus für hohe Zuverlässigkeit – Nachweis von Flussmittelrückstand und Aktivator auf Baugruppen“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03 (2000). |
| [Schw01a] | H. Schweigart, „No clean und bleifrei: ein Widerspruch?“, Productronic, Heft 10 (2001) 1-2. |
| [Schw01b] | H. Schweigart, „Fehlursachen klimatisch beanspruchter Elektronikschaltungen“, SMT, Heft 04 (2001) 18-20. |
| [Schw03a] | H. Schweigart, S. Repp; „Oberflächenreinheit bei Bond- und Coating Prozessen“, JOT, Heft 11 (2003) 36-38. |
| [Schw03b] | H. Schweigart, S. Strixner, A. Mühlbauer; „Optimal Reinigen unter BGAs?“, Productronic, Heft 12 (2003). |
| [Schw03c] | S. Repp, H. Schweigart, „Zuverlässigkeit steigern – Reinigen in der Elektronikfertigung“, Metalloberfläche, Heft 11 (2003) 35-38. |
| [Schw03d] | H. Schweigart, „Brauchen Coatings Reinigung?“, VTE Verbindungstechnik in der Elektronik, 15, Heft 01 (2003) 20-24. |
| [Schw04] | H. Schweigart, „Reinheitsanforderungen und Reinigung vor der Beschichtung“, in: DVS/GMM (Hrsg.), GMM-Fachbericht, Band 44 „Elektronische Baugruppen“, Vorträge der DVS/GMM-Fachtagung 04./05. Februar 2004 in Fellbach; S. 321-325. |
| [Schw05] | H. Schweigart, „Oberflächencharakterisierung vor der Beschichtung“, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 09. Juni 2005, Berlin, Tagungsband. |
| [Schw06a] | H. Schweigart, S. Strixner, „Coatings schnell und kostengünstig prüfen – Testmethode zur Überprüfung von Schutzlackierungen elektronischer Baugruppen“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 5-6 (2006) 96-97. |
| [Schw06b] | H. Schweigart, „Wenn der Lack abgeht – Mindestreinheit der Oberfläche vor der Schutzbeschichtung“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 10 (2006) 30-32. |
| [Schw07a] | H. Schweigart, D. Borgend, „Bauelemente-Vorbehandlung durch Reinigung“, Seminarunterlagen der Fachveranstaltung „Vergussstechnik für die Elektrotechnik und Elektronik“ im Haus der Technik, Essen, 22. März 2007. |
| [Schw08] | H. Schweigart, „Beschichtungsprobleme? – So hält ihr Lack!“, SMT 21 Heft 5 (2008) 22-25. |
| [Schw09] | H. Schweigart, „Sichere Lackhaftung durch Reinigung vor dem Beschichten“, PLUS, Mai (2009) S. 1126-1130. |
| [Sei07] | A. Seiwert, T. Lauer, „Der Vorteil eines modernen Reinigungsprozesses“, SMT Germany, Heft 6-7 (2007) 19-20. |
| [Sei08] | A. Seiwert, „Reinigung von Flachbaugruppen als Vorbehandlung zum Klimaschutzüberzug“, GMM-Fachbericht Band 55 (ISBN 978-3-8007-3074-2) „Elektronische Baugruppen und Leiterplatten EBL 2008“, 4. DVS/GMM-Fachtagung, 13./14.02.2008, Fellbach, S. 323-328. |
| [Sil89] | „Silicone: Chemie und Technologie“, Vulkan-Verlag, Essen, (1989). |
| [Sil01] | „Übersicht über die Silicon-Chemie“, Firmenschrift der Fa. Dow Corning Corp., (2001); veröffentlicht in erster Version von A. Colas unter dem Titel „La chimie des silicones“ in Chimie Nouvelle, Vol. 8 (30) (1990) 847. |
| [Smt09] | „Reinigung – ein unverzichtbarer Prozessschritt“, SMT, 23 (2010), Heft 05 S. 24-25 |
| [Ste07] | M. Stephan, „Silicones for Automotive Electronics Applications: Advances in Adhesives and Thermal Materials“, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 21. Juni 2007, Berlin, Tagungsband. |
| [Sti07] | M. Stieglmeier, „Wie finde ich meinen optimalen Reinigungsprozess – Handlungsempfehlungen für die Wahl des richtigen Reinigungsequipments“, EPP, Heft 10 (2007) S. 36-39 |
| [Str07] | S. Strixner, „In einem einzigen Prozess reinigen? – Bleifreie und bleihaltige Baugruppen“, Productronic, Heft 3 (2007) 28-31. |
| [Str10] | W. Strunz, H. Schweigart, „Impedanzspektroskopie als Werkzeug zur Qualitätssicherung von bestückten und unbestückten Leiterplatten“, EBL 2010, 5. DVS/GMM-Tagung, 24./25. Februar 2010, Fellbach, Tagungsband S. 142-147. (DVS-Berichte Band 265; ISBN 978-3-87155-277-9) |
| [Sup00] | M. Suppa, „Der Einsatz von Vergussmassen in der Elektronik“, Teil 1: PLUS, Heft 03 (2000), Teil 2: PLUS, Heft 06 (2000), Teil 3: PLUS, Heft 08 (2000). |
| [Sup01a] | M. Suppa, M. Kollasa „Dickschicht-Beschichtungsstoffe und schnelle Schutzlackierprozesse – ein Widerspruch?“, PLUS, Heft 08 (2001) und Ref.-Nr. 152 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2001). |

| | |
|----------|--|
| [Sup01b] | M. Suppa, „ <i>Dickschichtbeschichtungsstoffe und schnelle Schutzlackierprozesse – Dick aufgetragen, schnell getrocknet</i> “, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 04 (2001). |
| [Sup02] | M. Suppa, „ <i>Conformal coatings for Component Protection</i> “, Circuits Assembly, Vol. 13, Heft 06 (2002). |
| [Sup03] | M. Suppa, „ <i>Schutzlacke und Vergussmassen als Beschichtungsstoffe für elektronische Baugruppen</i> “, VTE Aufbau- und Verbindungstechnik, Heft 01 (2003). |
| [Sup04a] | M. Suppa, „ <i>Die Schutzlackierung von elektronischen Baugruppen – von High-Solid-Lacken über wasserverdünnbare hin zu lösemittelfreien Schutzlacken</i> “, in: DVS/GMM (Hrsg.), GMM-Fachbericht, Band 44 „Elektronische Baugruppen“, Vorträge der DVS/GMM-Fachtagung 04./05. Februar 2004 in Fellbach; S. 287-294 bzw. als Ref.-Nr. 159 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2004). |
| [Sup04b] | M. Suppa, „ <i>Reinheit und Beschichtung elektronischer Baugruppen – Klima- und Kriechstromzuverlässigkeit</i> “, Ref.-Nr. 160 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2004). |
| [Sup04c] | M. Suppa, „ <i>Ökologische Technologien und Beschichtungsstoffe für Leiterplatten</i> “, Ref.-Nr. 155 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2004). |
| [Sup04c] | M. Suppa, „ <i>Zuverlässigkeitsprüfungen und Ausfallmechanismen bei Lötstopplacken</i> “, VdL, ZVEI – Panel Discussion, „Erhöhte Anforderungen an die Zyklenfähigkeit von elektronischen Baugruppen“, SMT 2004. |
| [Sup04d] | M. Suppa, „ <i>Temperaturstress – Auswirkungen auf Schutzlacke in der Elektronik</i> “, Metalloberfläche, Heft 11 (2004) 35-38. |
| [Sup04e] | M. Suppa, „ <i>Der komplette Lifecycle ist entscheidend – Beschichtungsmaterialien für Leiterplatten aus ökologischer Sicht</i> “, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03 (2004). |
| [Sup05a] | R. Dietrich, P. Heuser, W. Peters, M. Suppa, „ <i>Schutzlacke und Vergussmassen als Beschichtungsstoffe für elektronische Baugruppen</i> “, Ref.-Nr. 150 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2005). |
| [Sup05b] | M. Suppa, „ <i>Thermische Beständigkeit von Schutzlacken</i> “, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 09. Juni 2005, Berlin, Tagungsband. |
| [Sup05c] | M. Suppa, „ <i>Silikone als Beschichtungsstoffe in der Elektronik</i> “, PLUS, Heft 9, (2005) 1609-1615. |
| [Sup05d] | M. Suppa, „ <i>Temperaturstress und Temperaturwechsellasts – Auswirkung auf Schutz- und Lötstopplacksysteme</i> “, Ref.-Nr. 161 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2005). |
| [Sup06a] | M. Suppa, „ <i>RoHS, ELV und WEEE und ihre Auswirkungen auf die Beschichtungsstoffe für die elektronische Industrie</i> “, Ref.-Nr. 162 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2006). |
| [Sup06b] | M. Suppa, „ <i>Silikone als Beschichtungsstoffe in der Elektronik</i> “, Ref.-Nr. 163 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2006). |
| [Sup06c] | M. Suppa, „ <i>Zuverlässigkeit von fotostrukturierbaren Lötstopplacken für elektronische Baugruppen bei Belastung durch Temperaturdauerstress und Temperaturwechselstress</i> “, DVS/DMM-Tagung, Fellbach, (2006) und PLUS, Heft 4, (2006) 659-666. |
| [Sup06d] | M. Suppa, „ <i>Temperaturresistente Schutzlacke</i> “, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Teil 1: Heft 1/2 (2006); Heft 4 (2006). |
| [Sup06e] | M. Suppa, „ <i>Schnellste Prozessierung von Schutzlacken mit der UV-Technologie</i> “, PLUS, Heft 6, (2006) 870-876. |
| [Sup06f] | M. Suppa, „ <i>Beschichtungsstoffe für elektronische Baugruppen bei Belastung durch hohe Temperaturen und hohe Feuchte</i> “, LPinfos, 40 (2006) 4-6. |
| [Sup06g] | M. Suppa, „ <i>The reliability of photoimageable solder resists</i> “, Circuitree, (2006). |
| [Sup07a] | M. Suppa, „ <i>Schutzlacke zur Verbesserung der Klimasicherheit elektronischer Baugruppen</i> “, Seminarunterlagen zum OTTI-Fachforum „Schutzmaßnahmen zur Klimasicherheit elektronischer Baugruppen“, März 2007, Regensburg. |
| [Sup07b] | M. Suppa, „ <i>Schutzlacke – Dickschicht-Beschichtungsstoffe und Applikationen – Teil 1</i> “, Productronic, Heft 7 (2007) S. 23-24. |
| [Sup07c] | M. Suppa, „ <i>Schutzlacke – Dickschicht-Beschichtungsstoffe und Applikationen – Teil 2</i> “, Productronic, Heft 8/9 (2007) S. 27-29. |
| [Sup07d] | M. Suppa, „ <i>Conformal coatings and their increasing importance for a safe operation of electronic assemblies</i> “, Circuit World, 33, Heft. 4 (2007). |

| | |
|---|---|
| [Sup08a] | M. Suppa, „Prüf- und Teststrategie Schutzlacke und Lotpasten und Prozesse“, GMM-Fachbericht Band 55 (ISBN 978-3-8007-3074-2) „Elektronische Baugruppen und Leiterplatten EBL 2008“, 4. DVS/GMM-Fachtagung, 13./14.02.2008, Fellbach, S. 157-164. |
| [Sup08b] | M. Suppa, T. Touré, „Feuchteschutz und Wärmeableitung bei LEDs durch Microverguss mit dem Dickschichtlack TWIN-CURE®“, Productronic, Sonderheft „light & building“, (2008) S. 22. |
| [Sup08c] | M. Suppa, „Die thermische Analyse in der Lack- und Beschichtungsanalytik“, LPinfos, 44 (2008) 4-7 |
| [Sup08d] | M. Suppa, „Deutlich erhöhte Schutzwirkung – Neues zu Dickschicht-Beschichtungsstoffen und ihren Applikationsprozessen“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 09 (2008) S. 75-77. |
| [Sup08e] | M. Suppa, „Schutzlackierung zur Verbesserung der Klimasicherheit elektronischer Baugruppen“, OTTI-Fachforum „Schutzmaßnahmen zur Klimasicherheit elektronischer Baugruppen“, 02.-03.04.2008 Regensburg, Tagungsband.. |
| [Sup08f] | M. Suppa, „Feuchte bleibt draußen, Wärme wird abgeführt, LED-Schutz durch Mikroverguss“, productronic SPEZIAL Mai 2008. |
| [Sup09a] | M. Suppa, „Schutzbeschichtung für elektronische Baugruppen bei Belastung durch hohe Feuchte und Betauung“, PLUS, Heft 5 (2009) S. 110-121. |
| [Sup09b] | M. Suppa, „Beschichtungsstoffe für die Elektronikindustrie - WEEE, RoHS, ELV und EuP nehmen auf verschiedensten Ebenen Einfluss - Teil 1“, Elektronik, 7, (2009) S. 50-53. |
| [Sup09c] | M. Suppa, „Schutzlacke für Elektronik-Baugruppen in Hochvoltanwendungen: Sicherer Schutz auch bei hoher Feuchtebelastung und Betauung“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 09 (2009) S. 40-42. |
| [Supp09d] | M. Suppa, „Im Blick – Farbmeterik zur Charakterisierung weißer Lötstopplacke“, Productronic, Heft 10 (2009) S. 55-57. |
| [Sup10a] | M. Suppa, H. Leiner, J. Tekath, „Schutzlacke, Lötstopplacke und Vergussmassen - optische Anforderungen und Leistungsfähigkeit bei LED Anwendungen“, EBL 2010, 5. DVS/GMM-Tagung, 24./25. Februar 2010, Fellbach, Tagungsband S. 111-119. (DVS-Berichte Band 265; ISBN 978-3-87155- 277-9) |
| [Tae08]; [Tae09]; [Tae10]; [Tae11] | Seminarunterlagen Technische Akademie Esslingen, „Vergießen und Verkapseln in der Elektrotechnik und Elektronik“, 13./14. März 2008, 15./16. September 2009, 12./13. Oktober 2010, 07./08. Juni 2011; Technische Akademie Esslingen, Ostfildern. |
| [Tau91] | C.J. Tautscher, „Contamination Effects on electronic products“ New York: M. Dekker, Inc., (1991). |
| [Teg98] | P.-E. Tegehall, „Impact of Contamination from Production Processes on the Reliability of Printed Board Assemblies“, Proc. Int. Conf. on Electronic Assembly: Materials and Process Challenges, pp. 69-80, (1998). |
| [Tut04] | Unterlagen zum Tutorial 25 „Reinheit und Beschichtung elektronischer Baugruppen – Klima und Kriechstromzuverlässigkeit“ – SMT HYBRID PACKAGING, Nürnberg, 15.-17.06.2004. |
| [Tut06] | Unterlagen zum Tutorial 24 „Die Schutzbeschichtung und ihre steigende Bedeutung für den sicheren Betrieb von elektrischen Baugruppen“ – SMT HYBRID PACKAGING, Nürnberg, 30.05. bis 01.06.2006. |
| [Weg00] | S. Wege, „Korrosionserscheinungen auf elektronischen Baugruppen unter Klimabeanspruchung“, Materials and Corrosion, 51, Heft 1 (2000) 7-12. |
| [Wei09a] | F. Weichhaus, „Vakuumverguss – worauf es wirklich ankommt“, Adhäsion, Ausgabe 6/2009, S. 31-35. |
| [Wei09b] | F. Weichhaus, „20 Jahre Garantie ... – Vergießen von Wickelgütern für die Photovoltaik“, Productronic, Heft 10 (2009) S. 66-67. |
| [Wei10a] | F. Weichhaus, „Lösungswort Vakuumfügen – Materialschonende Wärmeableitung der Platine auf Kühlkörper“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 10 (2010) S. ???. |
| [Wei10b] | F. Weichhaus, „Zur richtigen Zeit am richtigen Ort – Vergusstechnik: Automatisierte Fertigungsstraße für LSR-Anwendungen“, medizin & technik, Heft 02 (2010) S. 66. |
| [Wei10c] | F. Weichhaus, „Vacuum bonding for high-yield production“, U.S. Tech (2010) Heft 03/04. |
| [Wei10d] | F. Weichhaus, „A new economic reality: Looking at the lean side of manufacturing“, Adhesive Sealant Industry, (2010) Heft 09 S. 30-31 |

| | |
|----------|---|
| [Wei11a] | F. Weichhaus, „ <i>Gießharze von der Lagerung bis zur Verarbeitung im Bauteil</i> “, Dichtungstechnik Jahrbuch 2011, Hrsg. K.-F. Berger und S. Kiefer, Isgatec, Mannheim, (2010) S. 190-201. |
| [Wei10a] | F. Weichhaus, „ <i>Aufbereiten, Dosieren und Vergießen von Vergussmassen</i> “ unter www.scheugenpflug.de / news / presse |
| [Zas04] | H. Zastrow, K.-W. Lienert, G. Schmidt, „ <i>Lösemittelfreie Beschichtungen</i> “, in: DVS/GMM (Hrsg.), GMM-Fachbericht, Band 44 „Elektronische Baugruppen“, Vorträge der DVS/GMM-Fachtagung 04./05. Februar 2004 in Fellbach; S. 317-320. |
| [Zas05] | H. Zastrow, „ <i>Lösemittelfreie Beschichtung</i> “, GfKORR-Seminar „ <i>Beschichtung elektronischer Baugruppen</i> “, 09. Juni 2005, Berlin, Tagungsband. |

Außerdem werden in folgenden Firmenschriften regelmäßig Artikel zur Thematik der Anwendung und Erzeugung von Schutzbeschichtungen bzw. zum Verguss von elektronischen Baugruppen veröffentlicht:

- **Coating Newsletter**

(Kundeninformation der Fa. KC Produkte GmbH; www.kc-produkte.com; erscheint zwei- bis dreimal im Jahr)

- **LPinfos**

(Kundenzeitschrift der Fa. Lackwerke Peters GmbH + Co. KG; www.peters.de; erscheint zweimal pro Jahr)

- **Scheugenpflug update**

(Kundenzeitschrift der Fa. Scheugenpflug AG; www.scheugenpflug.de; erscheint zweimal pro Jahr)

- **ZESTRON news**

(Kundeninformation der Fa. Zestron; www.zestron.com; erscheint dreimal pro Jahr)